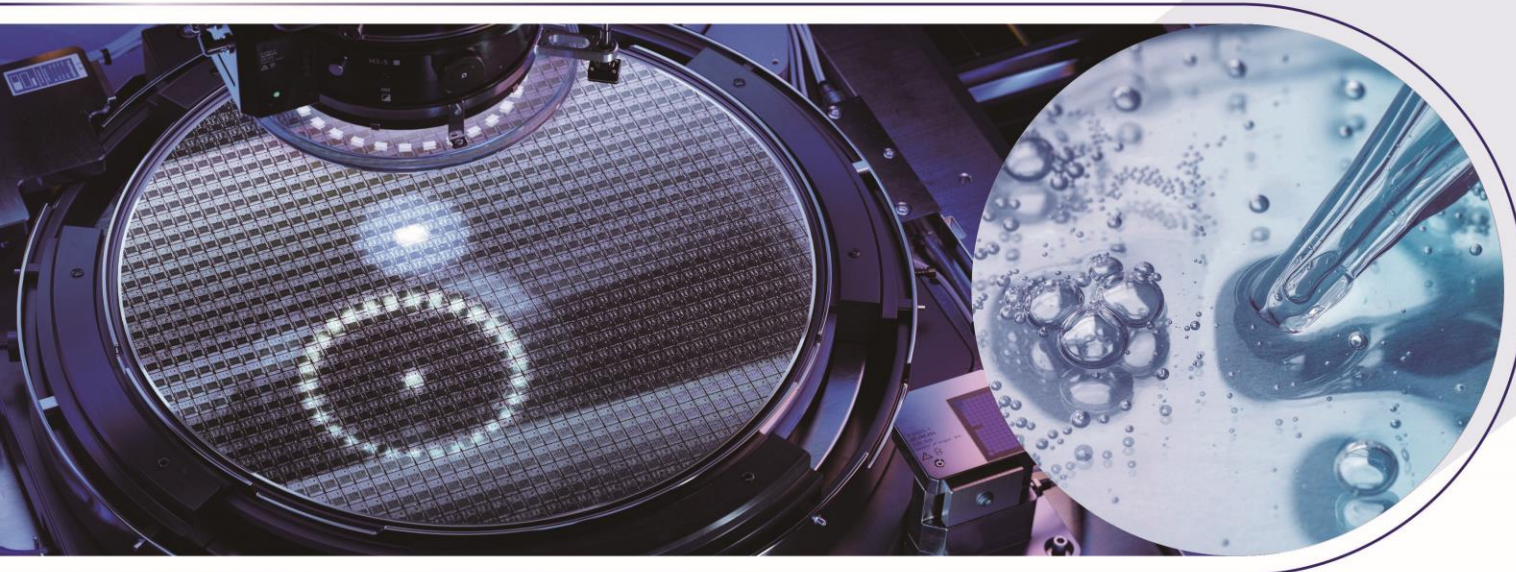


Semiconductor Application Materials

반도체 제조의 핵심 공정인 Photo 공정에 사용되는 정밀화학 소재로,
합성(Synthesis)와 정제(Purification) 기술을 기반으로 합니다.



SAMYANG
NC CHEM

2026. 05. 22

Disclaimer

본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 삼양앤씨켐 (이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약에 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

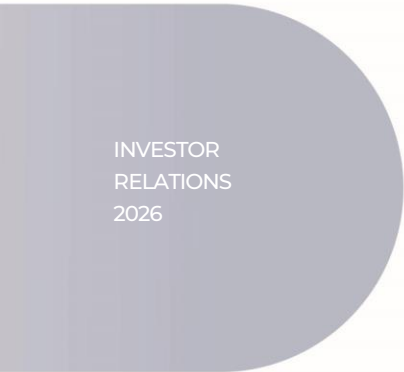


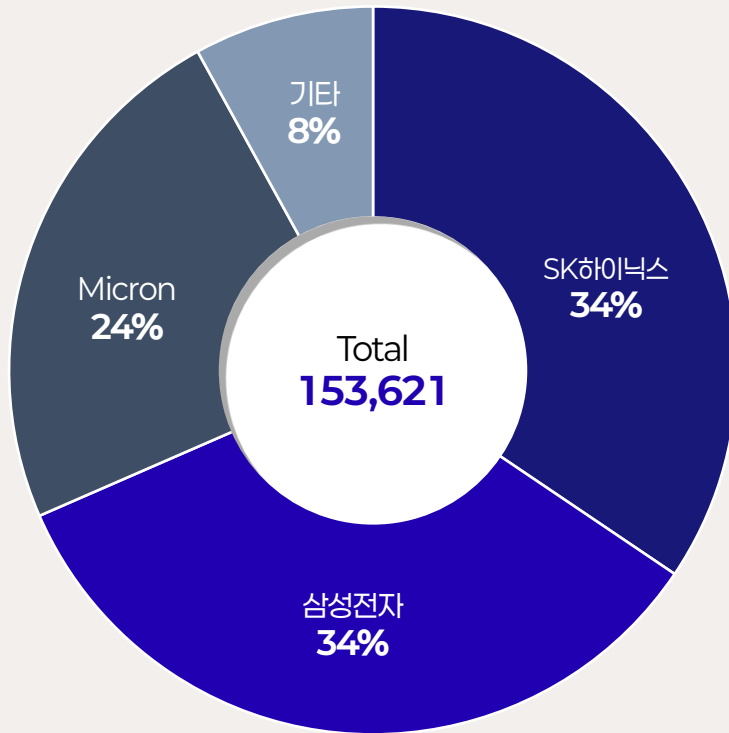
TABLE OF CONTENTS

Prologue	CHAPTER 1. 회사소개	CHAPTER 2. 핵심 경쟁력	CHAPTER 3. 성장전략	Appendix
----------	--------------------	----------------------	--------------------	----------

글로벌 메모리 반도체 시장에서 국내 기업이 절대적인 지위

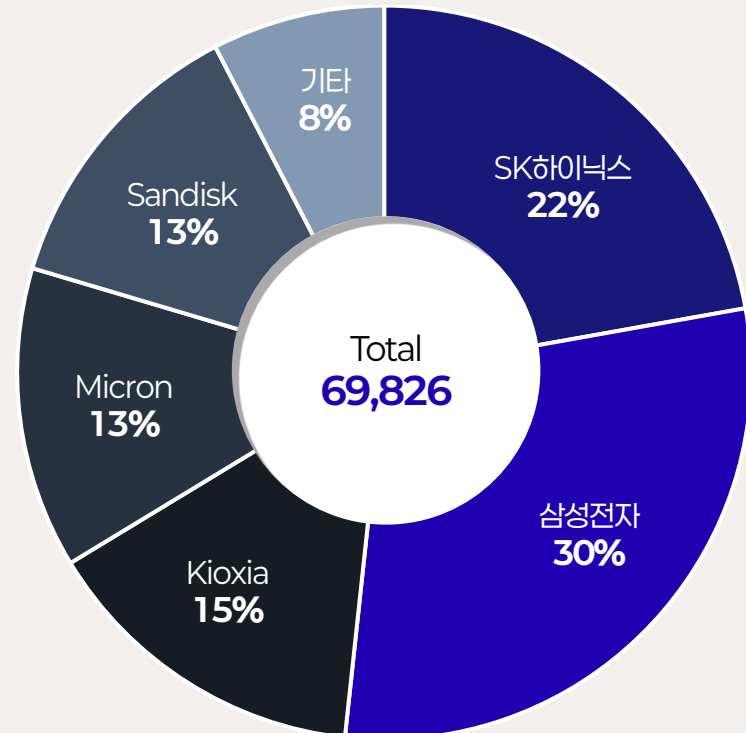
DRAM 생산자별 매출액 비중(2025년 4분기누계)

단위 : Million USD



NAND 생산자별 매출액 비중(2025년 4분기누계)

단위 : Million USD



반도체 공정 소재에 대한 이해

반도체 노광 공정의 필수 소재인 포토레지스트 국산화율 미흡, 포토레지스트 소재 국산화 시급

반도체 Process

● 설계

● 전공정

● 후공정

● 검사

1. 산화(Oxidation)

2. 노광(Photo/Lithography)

3. 식각(Etching)

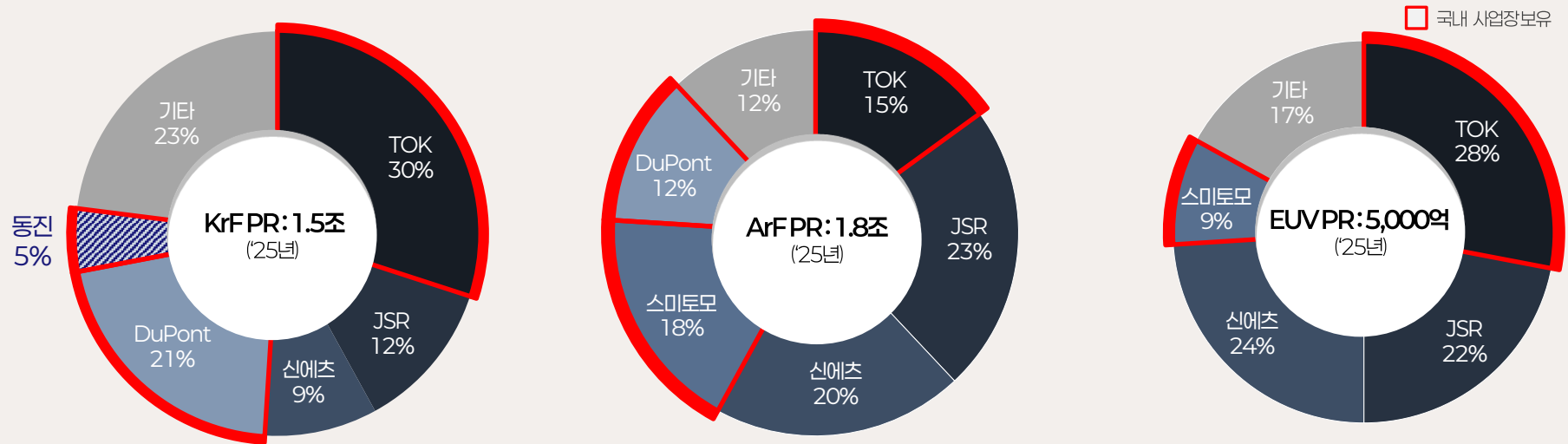
4. 확산(Diffusion)

5. 증착(Deposition)

6. 평탄화(CMP)

7. 세정(Cleaning)

글로벌 포토레지스트 시장 현황 (2025년 기준)



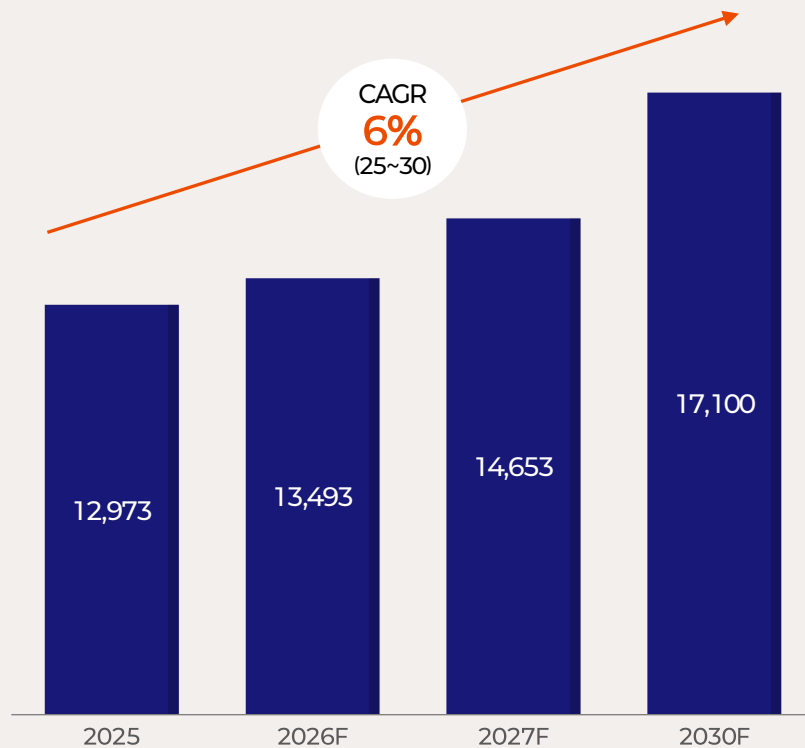
출처: 당사추정

노광 공정 소재 포토레지스트 시장에 대한 이해

반도체 지속 성장 전망(CAGR 6%, '25~30)에 따른 포토레지스트 소재 시장 성장세 지속

글로벌 반도체 웨이퍼 출하량(MSI) 전망

■ MSI (MillionSquareInches)

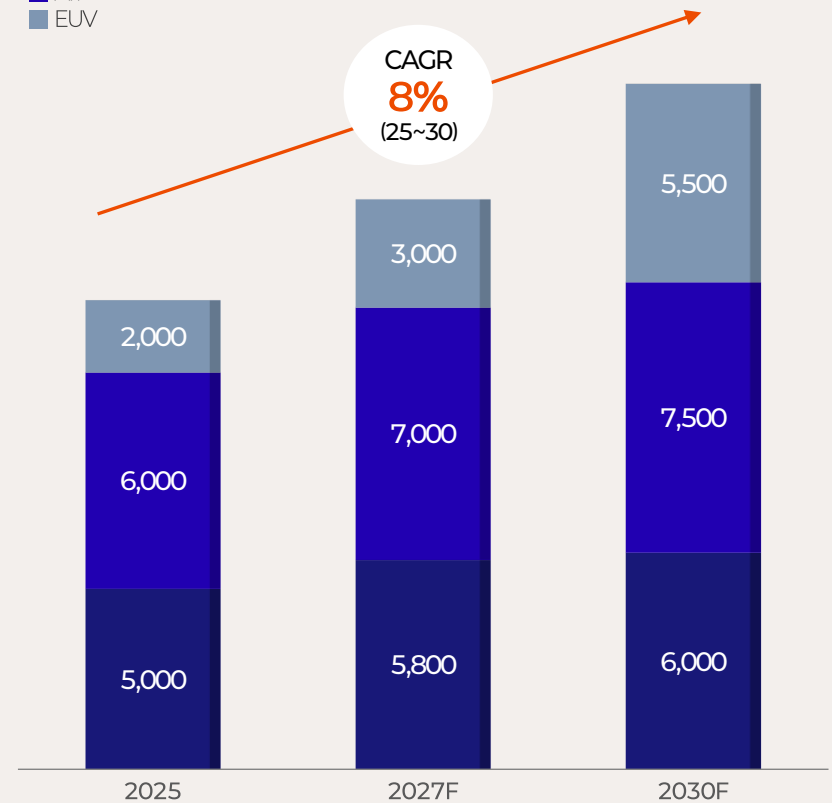


출처:SEMI

국내 포토레지스트 시장 전망

■ KrF
■ ArF
■ EUV

단위 : 억원



출처:당사내부자료

삼양엔씨켐은 광원에 따른 최적화된 포토리지스트용 재료 공급

포토리지스트 밸류체인



밸류체인대표 기업

국내 포토리지스트 생산업체 현황

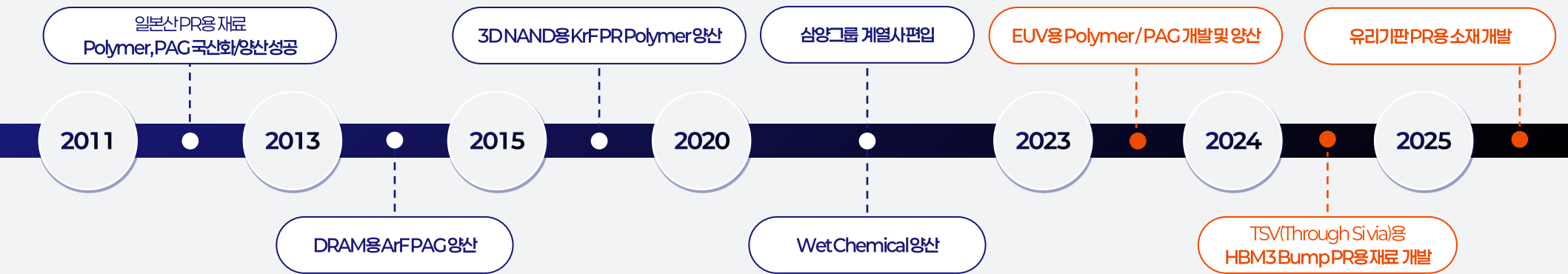
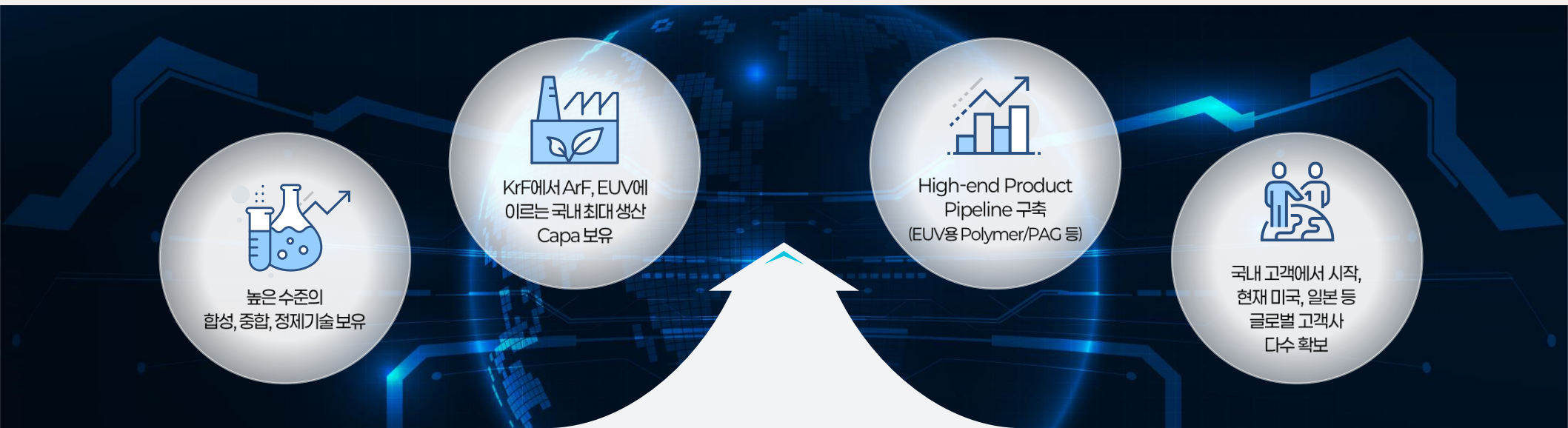
업체명	특징
TOK	KrF, ArF, EUV PR 국내 생산중
Qnity (前 DuPont)	KrF, ArF, EUV PR 국내 생산중
동우회인켐 (Sumitomo)	KrF, ArF PR 국내 생산중
동진씨미켐	KrF, ArF, EUV PR 국내 생산중
SKMP	KrF, ArF, EUV PR 국내 생산중

주요 고객사별 포토리지스트용 재료 공급 및 개발 현황

	KrF PR		ArF PR		EUV PR	
	Polymer	PAG	Polymer	PAG	Polymer	PAG
A사	당사 타사	당사 타사	당사 타사	당사 타사	당사	타사
B사	당사 타사	당사 타사	개발중 타사	개발중 타사	타사	타사
C사	당사 타사	타사	개발중 타사	당사 타사	개발중 타사	당사 타사
D사	당사 타사	개발중 타사	개발중 타사	개발중 타사	당사 타사	당사 타사
E사	개발중 타사	타사	타사	타사	타사	타사

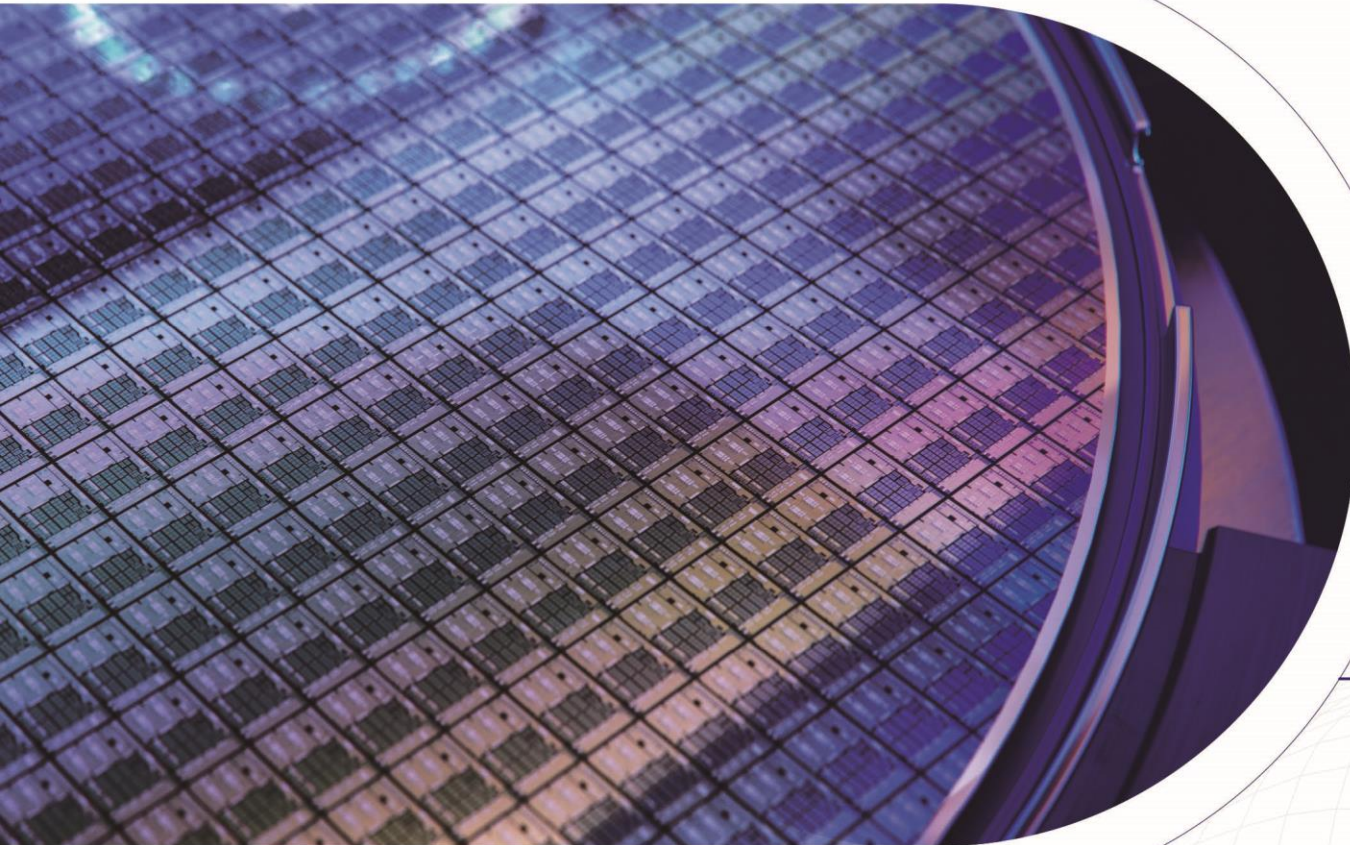
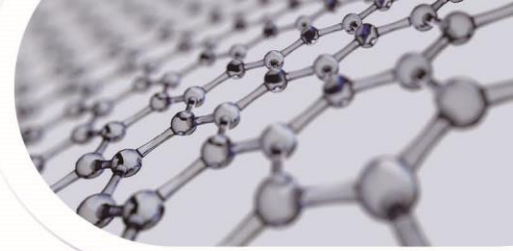
CI(Corporate Identity)

국내 최초로 포토레지스트용 재료 국산화, 반도체용 정밀화학 소재 전문 기업으로 자리매김



Semiconductor Application Materials

반도체용 정밀화학소재 전문 생산 기업



CHAPTER 1

회사소개

- 01. 회사 개요
- 02. 회사 연혁
- 03. 사업 영역
- 04. 경영 성과

SAMYANG
NC CHEM

01 회사 개요

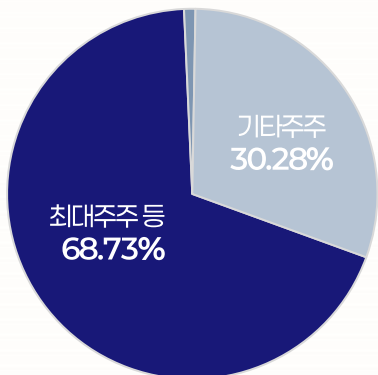
포토레지스트용 소재 생산 전문 기업, 삼양엔씨켐

회사 개요

회사명	주식회사삼양엔씨켐
대표이사	정회식
설립일	2008년 3월
자본금	109억*
임직원수	235명
주요사업	반도체 감광액용 재료
본사소재지	경기도 화성시 동탄산단 7길 98-34
홈페이지	https://www.samyangncchem.com

*2026년 1분기 재무제표 기준

주주 현황



2026.03.31 (단위: 주, %)

주주	주식수	지분율
최대주주 등	15,043,662	68.7
우리사주조합	215,952	1.0
기타주주	6,628,666	30.3
합계	21,888,280	100.0

대표이사 소개

정 / 회 / 식 대표이사

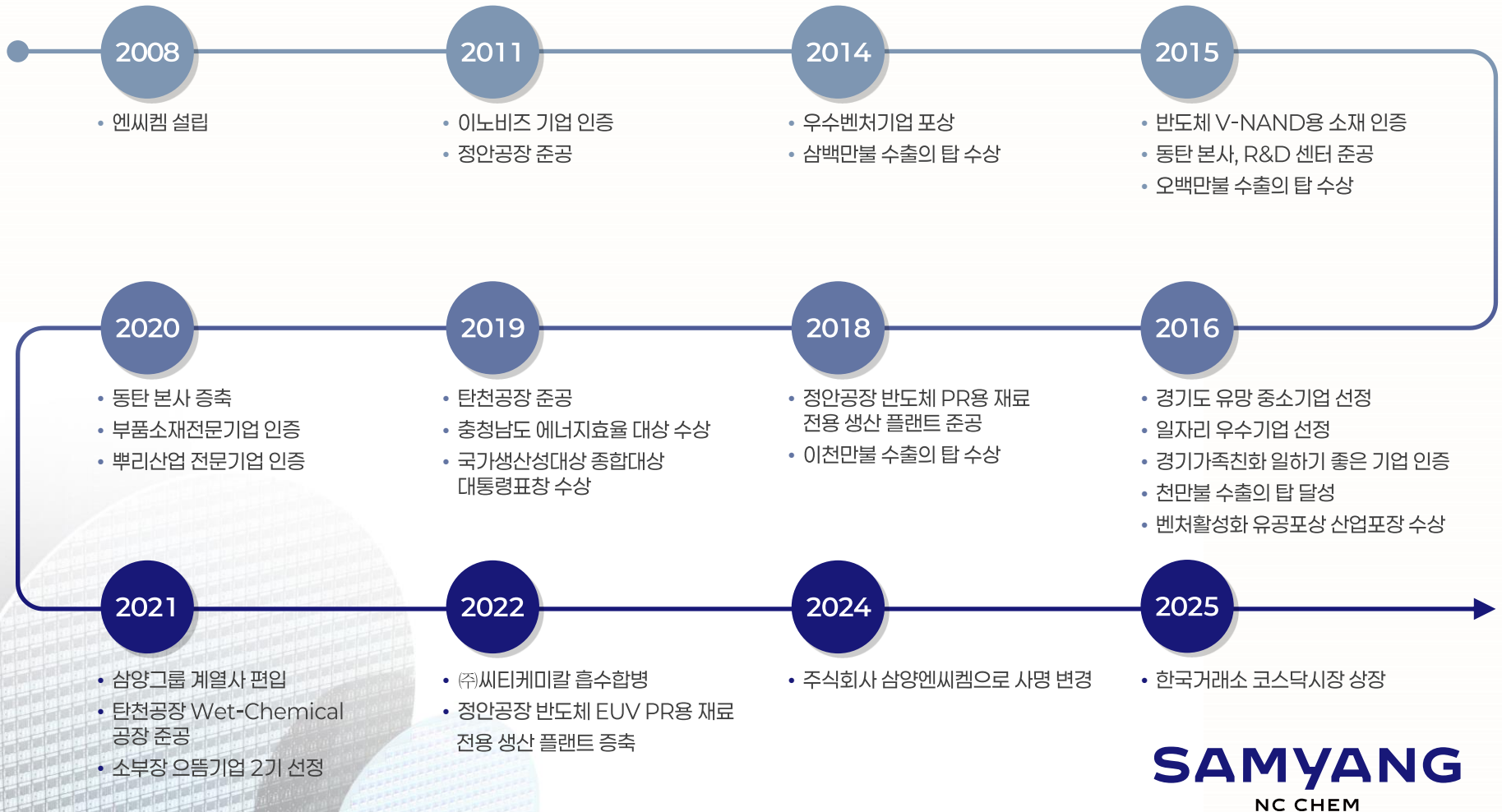


- 서울대학교 화학과 석사
- KAIST 화학과 박사
- 93~03 삼성전자 반도체 사업부 그룹장
- 03~09 Rohm & Haas Korea (現 DuPont Korea) 대표이사
- 09~12 Avantor Performance Materials Korea 대표이사
- 12~13 와이씨켐 부사장
- 14~15 Pall Korea Ltd. 대표이사
- 15~22 Pfeiffer Vacuum Semi Korea 대표이사
- 22~現 (주)삼양엔씨켐 대표이사

성명	직위	담당업무	주요경력
이창호	전무이사	영업/마케팅총괄	<ul style="list-style-type: none"> • 한양대학교 물리학과 석사 • 96~97 삼성종합화학 엔지니어 • 98~18 삼성전자 수석 • 19~22 원익머트리얼즈 상무 • 23~現 (주)삼양엔씨켐 영업/마케팅총괄
김용학	전무이사	생산총괄	<ul style="list-style-type: none"> • 충남대학교 화학사 • 00~10 솔브레인 차장 • 11~22 삼양사 부장 • 22~現 (주)삼양엔씨켐 생산총괄
정진향	전무이사	연구소장	<ul style="list-style-type: none"> • KAIST 화학과 박사 • 95~14 삼성전자 반도체 포토파트 그룹장 • 14~24 ASML Field Marketing Director • 25~現 (주)삼양엔씨켐 연구소장
진교원	전무이사	경영지원총괄	<ul style="list-style-type: none"> • 수원대 전자재료공학과 석사 • 98~03 LG디스플레이 책임연구원 • 04~08 JSR 과장 • 08~22 삼양사 팀장 • 22~現 (주)삼양엔씨켐 경영지원총괄
이상규	상무이사	재경팀장	<ul style="list-style-type: none"> • 한국외국어대 경영학과 학사 • 95~03 국민인스 회계팀 대리 • 03~12 동우화인켐 재무팀장 • 13~19 코스틸 전략재무본부장 • 19~現 (주)삼양엔씨켐 재경팀장

02 회사 연혁

꾸준한 연구개발을 기반으로 국내 최대의 포토레지스트 소재 선도기업으로 성장



03 사업 영역

광원별로 다양한 소재 포트폴리오를 구축

포토리지스트(PR)용 소재

고분자 (Polymer)

포토리지스트(PR)의 주요 구성성분으로 형체를 이루는 뼈대 역할을 하며 접착성, 저항성을 가지는 기계적 특성을 가진 재료

패턴의 특성을 결정하는 메인 소재

- KrF PR용 Polymer
- ArF PR용 Polymer
- EUV PR용 Polymer
- Bump PR용 Polymer
- BARC용 Polymer



광산발산제 (PAG)

빛에 반응하는 소재로 빛을 받으면 산을 발생시켜 고분자(Polymer) 반응 촉매 역할을 함

패턴의 해상도 향상에 기여하는 소재

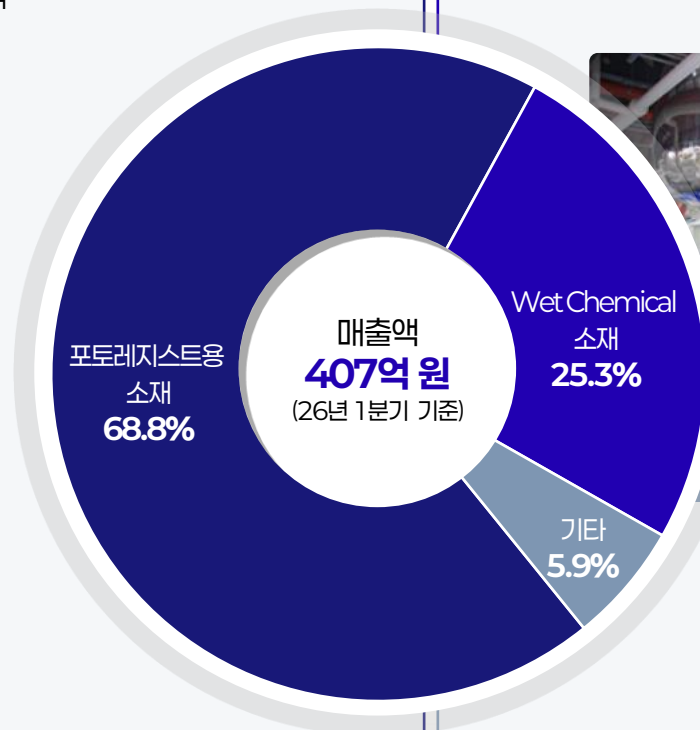
- KrF PR용 PAG
- ArF PR용 PAG
- EUV PR용 PAG



Wet Chemical 소재

PERR 중간체 (Post-Etch Residue Remover)

식각 공정 후 반도체 웨이퍼 표면에 남은 다양한 잔류물을 제거하는 역할을 수행



기타 매출

상품 매출 등

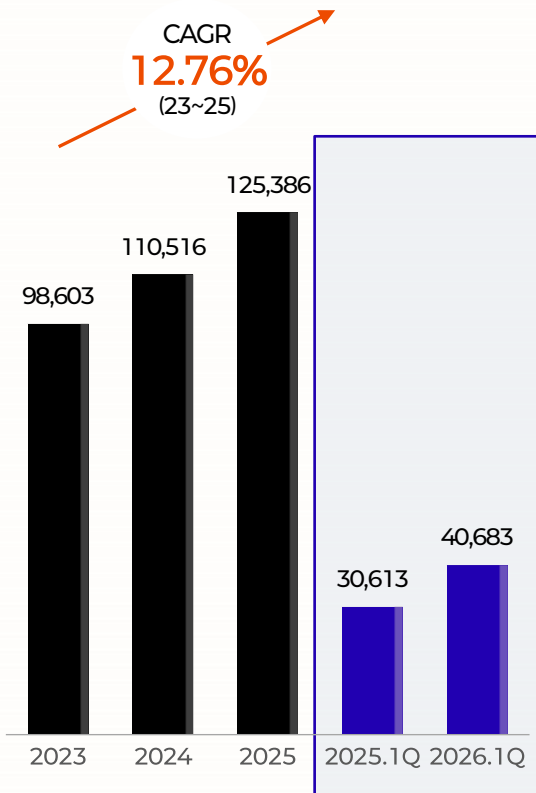
국내 반도체 제조사向 원료/제품 정제

04 경영 성과

고부가가치 제품 매출 확대 및 원가 절감 활동으로 인한 이익 증대

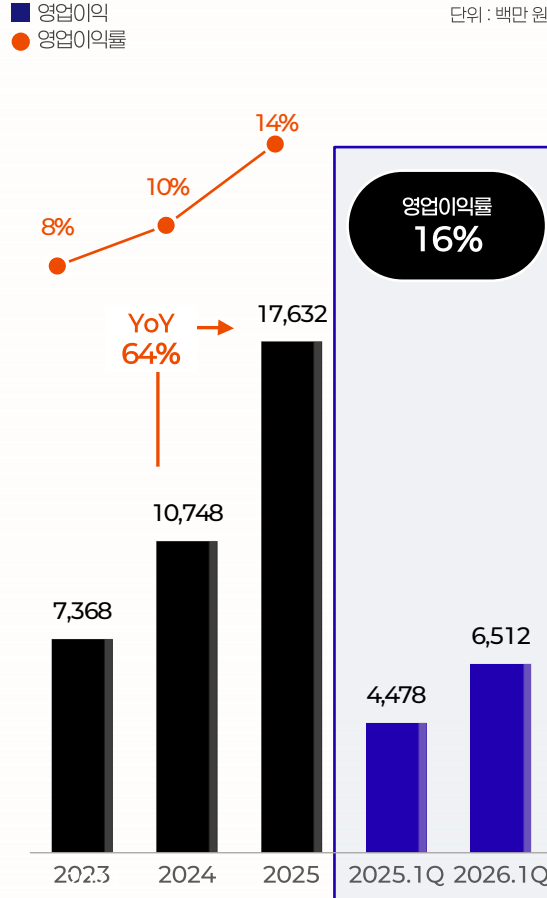
매출액

단위 : 백만 원



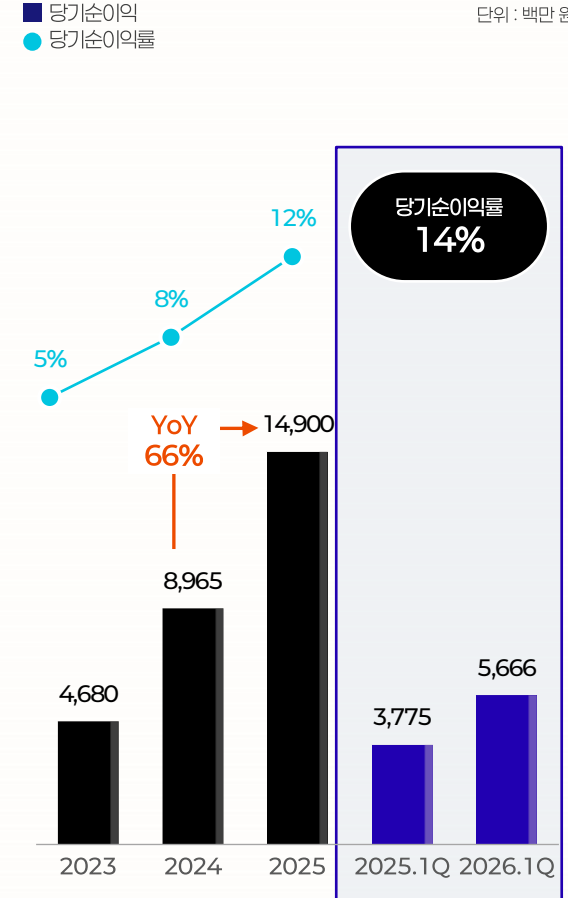
영업이익(률)

단위 : 백만 원, %



당기순이익(률)

단위 : 백만 원, %



Semiconductor Application Materials

반도체용 정밀화학소재 전문 생산 기업



CHAPTER 2

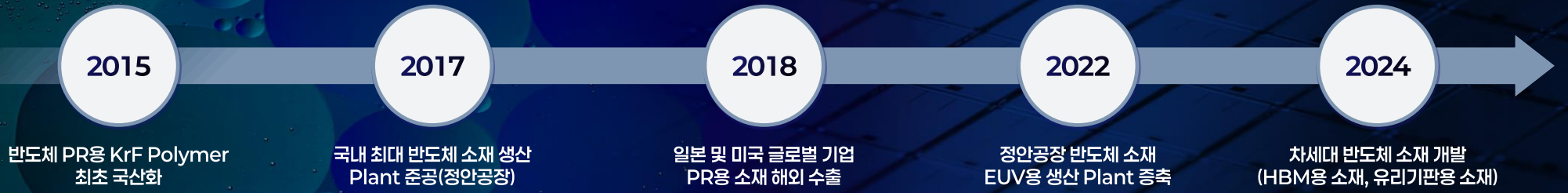
핵심 경쟁력

01. 반도체포토리소그래피용 핵심소재 국산화 Leading 기업
02. 고객사 평가로 입증되는 삼양엔씨켐의 기술 품질 경쟁력
03. 국내 최대 규모의 생산 능력 확보
04. 삼양엔씨켐만의 차별적 우수 확보

SAMYANG
NC CHEM

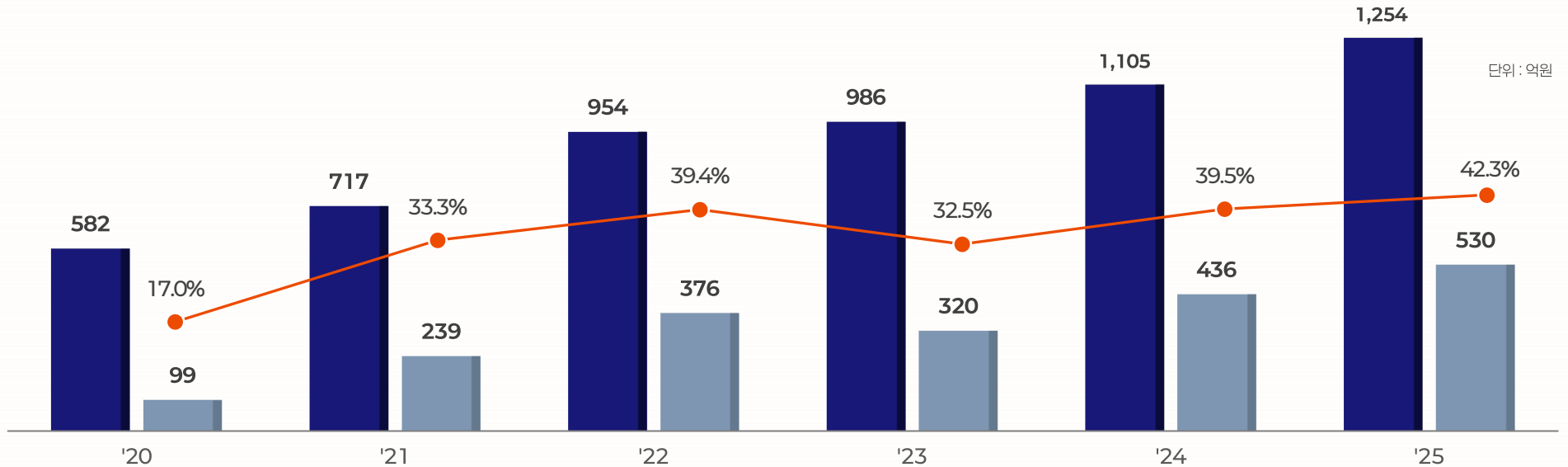
01 반도체 포토레지스트 핵심 소재 국산화 Leading 기업

글로벌 레퍼런스를 갖춘 반도체 Photo 핵심 소재 국산화 Leading 기업



국내 진출 글로벌 기업 매출 추이

■ 전체 매출액 ■ 글로벌 기업 매출액



02 고객사 평가로 입증되는 삼양엔씨켐의 기술 품질 경쟁력

Ton 단위 양산시 ppb(Parts Per Billion)수준*의 Metal 관리 등 반도체용 고품질, 고순도 Chemical 양산

삼양엔씨켐의 핵심 기술력



합성기술 (Synthesis)

- Anion/Cation Coupling
- Scheme Process Design
- High Purity Performance



중합기술 (Polymerization)

- Monomer Composition Ratio
- Poly Disperse Index
- Molecular Weight



정제기술 (Purification)

- Metal Reduction
- Purification(Ion)
- Residual Solvent
- Halide (Cl, Br, I) 등

순도 99.9% 관리
Metal 27종/35종 (각각 1ppb / Total 10ppb)

고성능 분석장비 투자로 고순도/고품질 제품 개발



NMR 600Mhz-Prodigy
(Nuclear Magnetic Resonance)
고분자구조 분석장비



ICP-MS
(Inductively Coupled Plasma-
Mass Spectrometry)
금속불순물 분석장비

고객사별 최고 수준의 생산 품질 평가 등급

고객사	등급	비고
美 A社	RANK #1	Final Grade 91.9
日 B社	93	H 등급
日 C社	A	지표 달성률 100%

Score	1Q, 2025	2Q, 2025	3Q, 2025	4Q, 2025
Subst #1 Score (70%)	83.6	87.9	83.7	83.9
Subst #2 Score (30%)	30	30	28.2	28.5
Total Score	81.6	87.9	81.9	80.1
Ranking	#2	#1	#1	#1

美 A社: QTRM Report (2025.4Q)

日 B社: 협력사품질평가

日 C社: 협력사평가

03 국내 최대규모의 생산능력 확보

미래를 위한 선제적 투자를 통해 매출 확대를 위한 CAPA 확보



본사 동탄연구소

소재지: 경기도 화성시 동탄산단7길 98-34
면적: 2,245m²
주요업무: R&D



정안공장

소재지: 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-102
면적: 12,668m²
주생산품: KrF/ArF/EUV용 소재 (Polymer, PAG)



탄천공장

소재지: 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 70
면적: 29,581 m²
주생산품: Wet Chemical, Bump Polymer

미래를 위한 선제적 투자 진행



제품별 생산 Capa (2025년 기준)



04 삼양엔씨켐만의 차별적 우위 확보

반도체 소재 생태계 안에서 우수한 기술력과 품질 관리 경쟁력 형성

기술

Core 기술

- PR용 Polymer/PAG 합성/중합 기술력 보유
- Lab→Pilot→Mass 양산 프로세스 구축

국내 선도

- 국내 최초 KrF-P 국산화(3D NAND용)
- 글로벌 선도 기업과의 기술 협력 체계 구축

품질

품질 관리

- LIMS 도입을 통한 품질 Data 관리
- 고성능/고기능 분석장비로 고순도, 고품질 제품 품질관리

고객 대응

- 글로벌 고객 기준 품질 관리 인증 확보
- 고객 대응력 강화를 위한 전담 부서 운영

생산

생산 Capa

- 국내 최대 반도체 전용 Plant 보유
→ Polymer 300ton/年
PAG 20ton/年

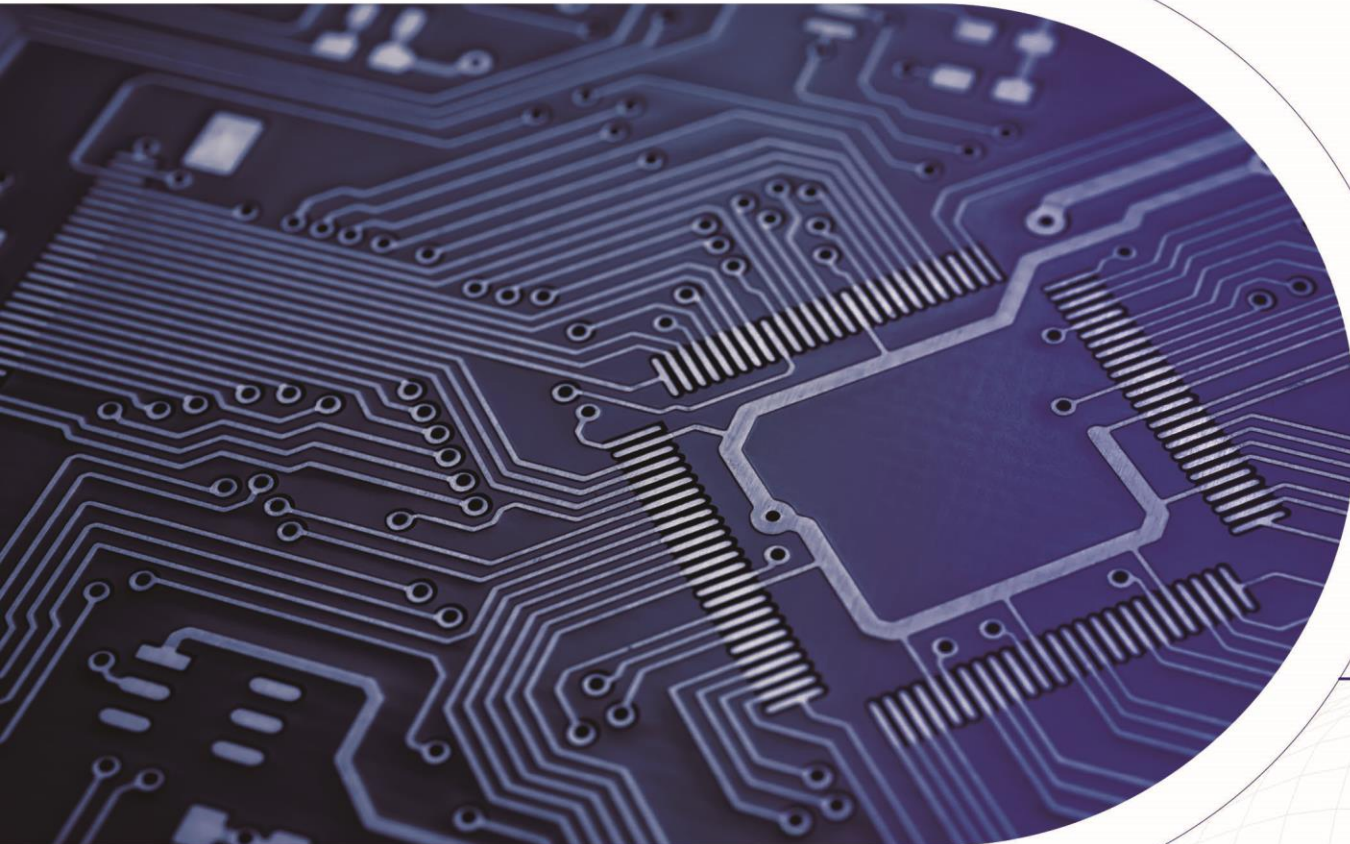
생산 역량

- 고순도, 고품질 양산 관리 능력 보유(ppb)
- 적시 납기 System(MES 등)

차별화된 경쟁력을 바탕으로 높은 진입 장벽 구축

Semiconductor Application Materials

반도체용 정밀화학소재 전문 생산 기업



CHAPTER 3

성장전략

01. 성장로드맵
02. 기존 사업역량강화를 통한 고객/제품 포트폴리오 다각화
03. 차세대 소재 확대(1) EUV 포토레지스트 소재
04. 차세대 소재 확대(2) 차세대 반도체 패키징 소재
05. 글로벌 시장 확장 전략
06. Executive Summary

SAMYANG
NC CHEM

01 성장 로드맵

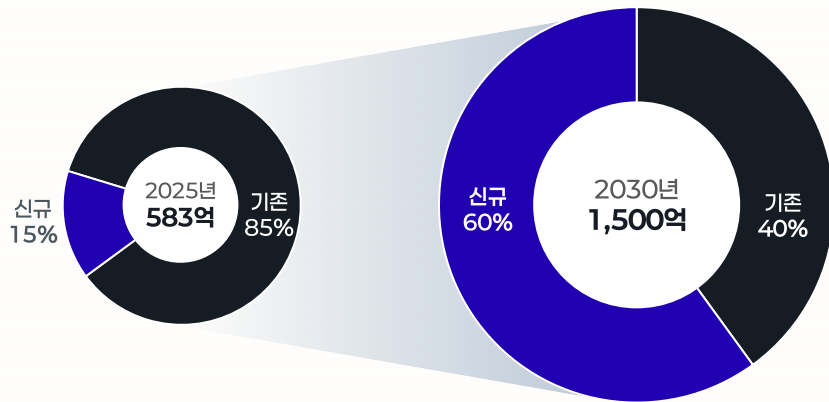
제품 고객 포트폴리오 고도화를 통한 첨단산업용 소재의 글로벌 리더로 성장



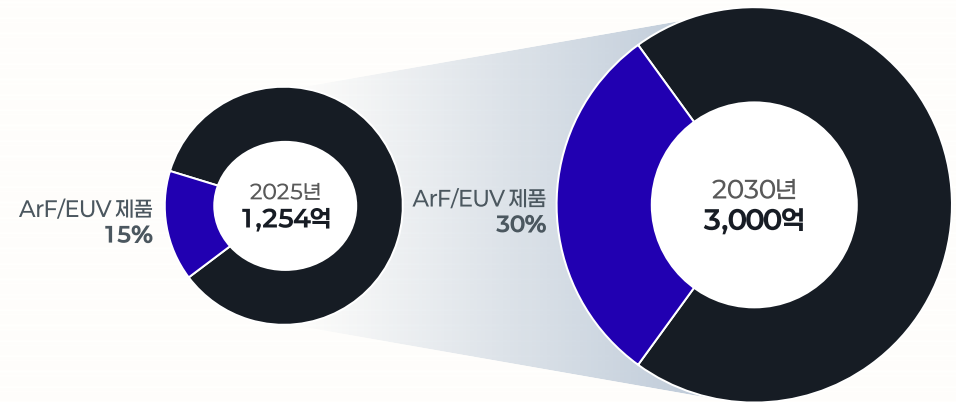
02 기존 사업 역량 강화를 통한 고객/제품 포트폴리오 다각화

기존 주력 제품인 KrF와 ArF를 고도화하여 고객사 다변화 달성

KrF Polymer 고객 포트폴리오 강화



ArF/EUV 제품 포트폴리오 확대



추진전략

기존 고객과 협력 관계 증진

- 메모리 반도체 수요 증가에 따른 NAND 향 제품 매출 지속

신규 고객 진입 및 확대

- High-end 제품 개발을 통한 글로벌 고객사 매출 확대

추진전략

고부가 제품 포트폴리오 확대

- KrF-P 위주의 매출에서 ArF-P/PAG, EUV-P/PAG로 확대

국내 제조 글로벌 PR 업체로 확장 추진

- 글로벌 고객사와의 협업을 통한 시장 확대

03 차세대 소재 확대 (1) EUV 포토레지스트 소재

고성능 반도체 수요 급증에 대응하는 EUV 포토레지스트 시장의 폭발적 성장 기대

EUV(Extreme Ultra Violet) 소개

Multiple Patterning Technology Mask

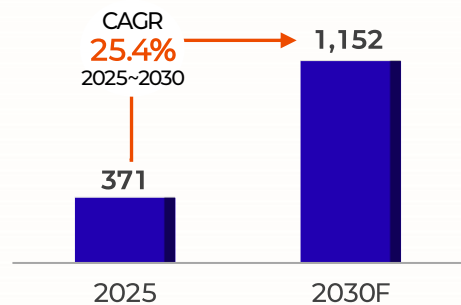
EUV Mask

- 극자외선 파장을 이용하는 차세대 노광 공정 기술
- KrF, ArF 등 기존 광원 대비 더욱 정밀한 회로 제작 가능
- 7 나노 이하 반도체 제조공정에 필수적인 기술

EUV PR용 소재 수요 증가

글로벌 EUV PR 시장 전망

단위: 백만 달러



출처: ValuatesReports



EUV 포토레지스트 소재 단계별 개발 현황

고객사	적용 제품	진행 현황	비고
A사	DRAM용 / 파운드리용	개발 중 3건	2026. 2H 상업화 예정
		상업화 1건	2025. 1Q
B사	DRAM용	상업화 2건	2023 ~
C사	DRAM용	Spec-In 완료 2건	2025. 2H
		개발 중 2건	2028. 1H 상업화 예정
		상업화 1건	2024 ~

국내 최고 수준의 소재 개발 기술력으로 시장 점유율 확대 기대

04 차세대 소재 확대 (2) 차세대 반도체 패키징 소재

고성능 고집적 패키징 구조 전반에 적용 가능한 소재 포트폴리오

차세대 반도체 패키징 구조 및 적용 영역

[HBM RDL & Si-interposer 구조]

- RDL(Redistribution Layer, 재배선층)
- 미세 배선 보호 및 전기적 신뢰성 확보 목적
- 고집적화로 인해 소재 신뢰성 요구 수준 상승

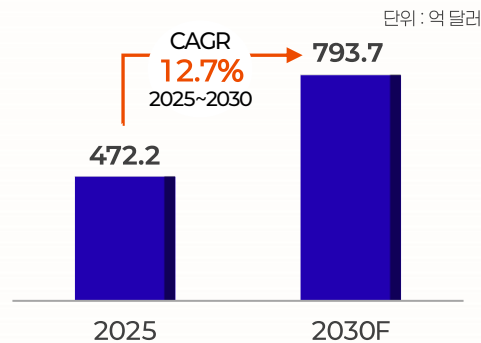
[Glass Substrate 구조]

- 낮은 열팽창계수(CTE)로 휨 현상 없음
- 평탄한 표면으로 미세 회로 구현 가능
- 차세대 HPC·AI 반도체 중심 적용 확대

반도체 고성능·고집적화로 패키징 구조 다변화로 RDL, Glass Substrate 등 차세대 패키징 소재 수요 확대

— 당사소재적용 주요 구간

글로벌 반도체 패키징 소재시장 규모



출처: MarketGrowthReports

차세대 반도체 패키징 소재 단계별 개발 현황

고객사	적용 제품	진행 현황	비고
A사	유리기판	개발 샘플 공급 및 평가 중	2026 개발 2027 양산
	HBM	개발 샘플 공급 및 평가 중	2027 양산
B사	HBM	개발 샘플 공급 및 평가 중	2025 개발 양산 준비 중
C사	유리기판	개발 로드맵 협의 중	2027 양산

차세대 패키징 구조 전반에 적용 가능한
핵심 소재 기술력으로 중장기 성장 기반 확보

05 글로벌 시장 확장 전략

지속 가능한 매출 확대를 위한 글로벌 전방 고객 확보

SAMYANG
NC CHEM



글로벌 수요 기반 다각화

日

국내 Site 양산 레퍼런스를 통한
일본 진출 추진

美

국내 Site 양산 레퍼런스를 통한
미국 고객 샘플 평가 중

臺

국내 Site 양산 레퍼런스를 통한
대만 진입 완료

中

중국向 PR용 소재 진입 추진

06 Executive Summary

글로벌 기술력을 바탕으로 반도체 소재 국산화를 선도하는 기업

1. 국내 최고 기술사업화 레퍼런스

국내 반도체 PR 제조사에 PR 소재를 공급하며 반도체 기술 국산화 주도

2. 글로벌 선도 고객사를 통한 매출 다변화

글로벌 PR 선도업체에 PR 소재를 공급하며 국내 → 글로벌 레퍼런스 확장

3. EUV용 고부가 소재 기술 선점

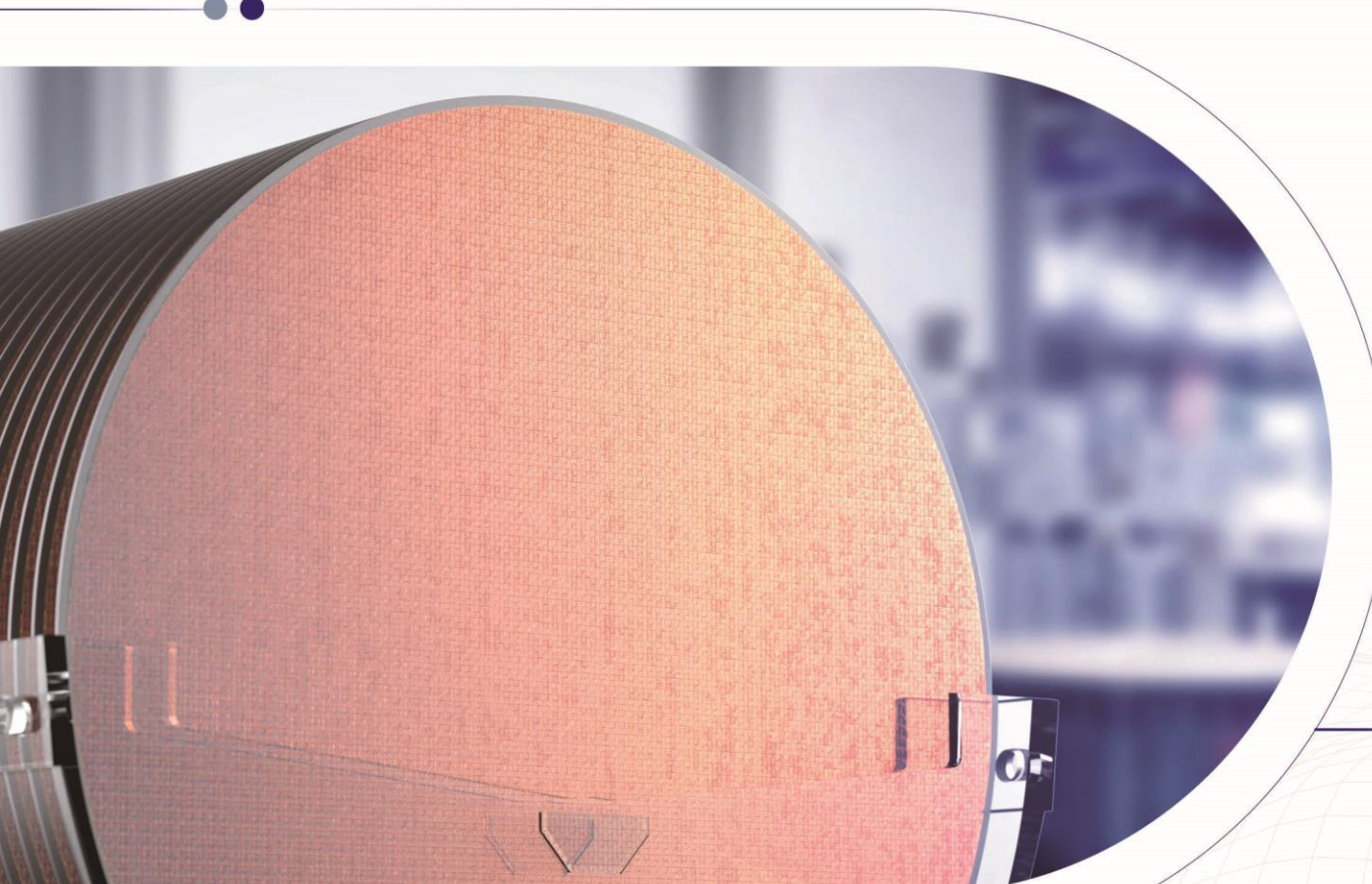
정밀합성/정제 기술 기반으로 EUV PR용 소재 상업화

4. 차세대 소재 지속적 발굴

HBM 및 유리기판 등 차세대 소재 상업화를 통한 지속 성장 기반 구축

Semiconductor Application Materials

반도체용 정밀화학소재 전문 생산 기업



Appendix

- 01. 요약재무제표
- 02. 노광공정및Photo-Resist소재

SAMYANG
NC CHEM

01 요약 재무제표

재무상태표

단위 : 백만 원

구분	2023	2024	2025	2026.1Q
유동자산	57,808	52,849	70,546	76,203
비유동자산	73,564	75,410	74,252	73,946
자산총계	131,372	128,259	144,798	150,149
유동부채	41,523	34,706	19,819	20,528
비유동부채	15,100	9,922	5,729	4,757
부채총계	56,623	44,628	25,548	25,285
자본금	1,616	4,849	5,472	10,944
자본잉여금	62,549	59,317	80,454	74,934
자본조정	(15,823)	(15,823)	(16,808)	(16,808)
이익잉여금	26,407	35,288	50,132	55,794
자본총계	74,749	83,631	119,250	124,865

주1 : KIFRS를 기준으로 작성.

포괄손익계산서

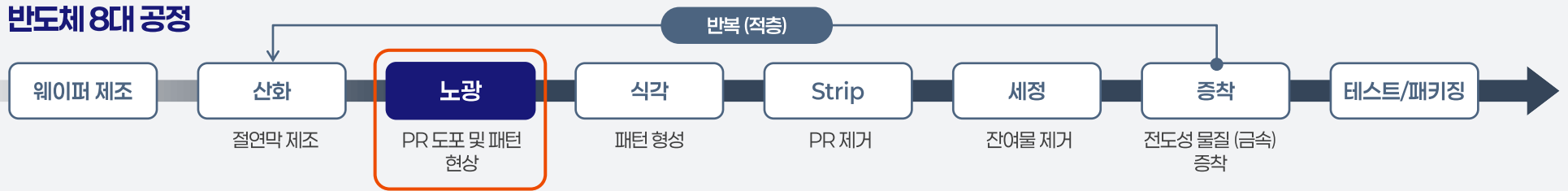
단위 : 백만 원

구분	2023	2024	2025	2025.1Q	2026.1Q
매출액	98,603	110,516	125,386	30,613	40,683
매출원가	81,947	88,057	93,757	22,625	29,867
매출총이익	16,656	22,459	31,629	7,988	10,816
판매비와관리비	9,288	11,711	13,997	3,509	4,304
영업이익	7,368	10,748	17,632	4,479	6,512
금융손익	(2,455)	(2,307)	(364)	(251)	(309)
기타손익	117	762	(611)	71	374
세전이익	5,031	9,203	16,657	4,299	6,577
법인세비용	351	238	(1,757)	(524)	(911)
당기순이익	4,680	8,965	14,900	3,775	5,666

02 노광 공정 Flow 및 원리

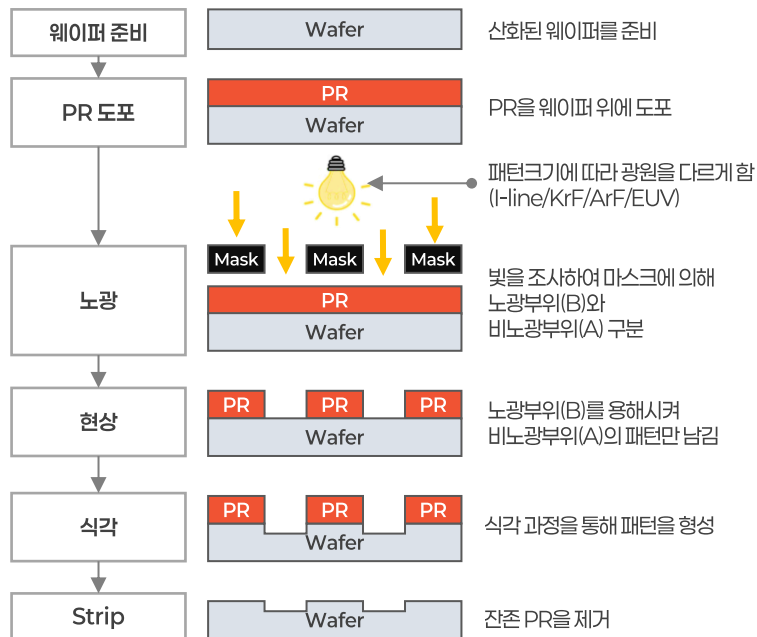
삼양엔씨켐은 포토레지스트(PR) 핵심 소재인 Polymer 및 PAG 생산

반도체 8대 공정



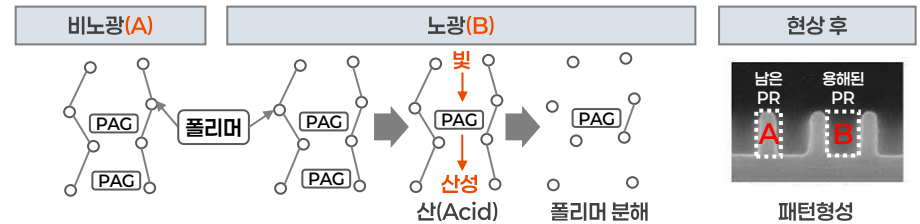
노광 공정

노광 공정 Flow



PR(Photoresist)의 구성 및 노광 원리

빛에 반응하는 PAG¹⁾의 화학 작용으로 폴리머가 쉽게 용해되는 물질로 변함.
[PR의 구성: 폴리머(<10%) + PAG(<1%) + 용매(>90%)]



광원의 종류 및 특성

종류	NAND		DRAM	Foundry
	I-line	KrF ²⁾	ArF ³⁾	EUV ⁴⁾
반응파장	365nm	248nm	193nm	13.5nm
패턴크기	㎍	100nm	45nm	13nm
해상도	낮음	높음		

1) PAG (Photo Acid Generator): 광산발생제
2) KrF: Krypton Fluoride
3) ArF: Argon Fluoride
4) EUV: Extreme Ultra-Violet